



电子行业：明确科技产业“十五五”期间重点地位，国产化替代有望加速

——“十五五”规划点评

事件：

北京时间 10 月 20 日至 23 日，党的二十届四中全会于北京举行，会议公报于 10 月 23 日发布，会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。

点评：

加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。此次在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中明确了科技产业在“十五五”期间的重点地位，主要从以下几个方面进行了部署，重点归纳为：一是加强原始创新和关键核心技术攻关；二是推动科技创新和产业创新深度融合；三是一体推进教育科技人才发展；四是深入推进数字中国建设。其中针对关键核心技术突破中提到：全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。同时提出前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点，这些产业蓄势发力，未来 10 年将再造一个中国高技术产业。

“十五五”规划有望加速半导体全产业链突破的关键阶段。在继续加强基础研究和关键核心技术攻关部署下，聚力开发新的模型算法、高端算力芯片，不断夯实人工智能发展的技术根基是“十五五”期间发展的主要目标。在过去政策与资本双重驱动下，国产芯片整体国产化率由 2021 年 10% 到 2024 年提高至 18%，其中 AI 芯片 2024 年中国品牌渗透率约 30%。在外部限制以及“十五五”明确规划的指引下，国产 CPU、GPU、模拟芯片、存储芯片、车规芯片等领域的替代需求空前迫切，看好国产芯片加速突破，国产化提升空间巨大。

国产设备与材料进程有望迎来加速期。半导体产业的核心竞争力，归根结底取决于设备能力。在地缘政治不确定性持续加剧，半导体设备作为中国主要的“卡脖子环节”，仍处于国产替代的黄金期。目前在 28nm 及以上领域，中国半导体设备厂商已基本实现了全覆盖，部分刻蚀、清洗环节已推进至先进制程节点，国产化率达 80% 以上。而在 14nm 工艺上，中国半导体设备厂商也实现了 50% 以上的覆盖，国产化率可能达到了 20% 以上。目前在 14nm 以下，国产化率仍较低，仅为 10% 左右。半导体制造是“设备 + 材料”协同发力的过程，半导体材料同样定义半导体制造工艺的能力边界。2024 年全球半导体材料市场由日本企业占据显著份额，达到 52%，继续引领行业格局。中国大陆是全球最大的半导体消费市场，但半导体材料产业仍处于快速发展阶段。在硅片、光刻胶、高纯化学品等领域依赖进口，本土企业仍处于正在加速突破的进程中。长期来看，在政策的指引下，随着国产设备与材料厂商技术与服务的不断成熟，设备与材料国产化比例逐年提升，国产设备与材料厂商有望受益，国产化率增长有望加速。

投资建议：“十五五”时期是我国应对科技革命加速、大国 AI 博弈和扩大内需

2025 年 10 月 29 日

看好/维持

电子

行业报告

未来 3-6 个月行业大事：

暂无

资料来源：同花顺

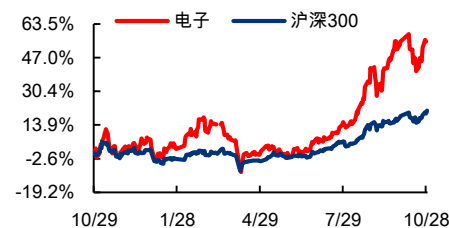
行业基本资料

占比%

股票家数	340	7.55%
行业市值(亿元)	130675.71	11.25%
流通市值(亿元)	112407.24	11.69%
行业平均市盈率	75.48	/

资料来源：恒生聚源、东兴证券研究所

行业指数走势图



资料来源：恒生聚源、东兴证券研究所

分析师：刘航

021-25102913

liuhang-yjs@dxzq.net.cn

执业证书编号：

S1480522060001

研究助理：李科融

021-65462501

likr-yjs@dxzq.net.cn

执业证书编号：

S1480124050020

战略的关键阶段，国产 CPU、GPU、模拟芯片、存储芯片、车规芯片等领域的替代需求空前迫切，看好国产芯片加速突破，国产化提升空间巨大。半导体设备与材料共同定义半导体制造工艺的能力边界，在政策的指引下，国产化率有望加速，受益标的：（1）AI 芯片：寒武纪、海光信息等；（1）模拟芯片：圣邦股份、思瑞浦、希荻微等；（2）存储芯片：兆易创新等；（3）晶圆制造：中芯国际、华虹公司；（4）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技等；（5）半导体材料：推荐江丰电子、沪硅产业。

风险提示：市场竞争加剧；政策进一步变化的风险；国产技术研发不及预期。

相关报告汇总

报告类型	标题	日期
行业深度报告	电子行业 2025 年中期展望：AI 浪潮推动电子行业进入新发展阶段，三大核心领域增长动能值得关注	2025-06-12
行业深度报告	【东兴电子】激光雷达行业五问五答—新技术前瞻专题系列（九）	2025-05-30
行业深度报告	电子行业：2024 年电子板块迎来复苏，2025 一季度营收利润同环比均实现快速增长—行业年报点评	2025-05-23
行业普通报告	电子行业：关税壁垒倒逼产业升级，国产化替代有望加速—中美关税政策点评	2025-04-08
行业深度报告	偏光片行业：解码偏光片国产替代加速与中大尺寸增量机遇 ——泛半导体材料研究系列之二—泛半导体材料研究系列之二	2025-03-26
行业深度报告	爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示	2025-03-14
行业深度报告	人形机器人专题系列（一）：传感器的技术路径、竞争格局与产业重构	2025-03-06
行业深度报告	国产算力 AI 芯片专题：一文读懂华为昇腾 310 芯片—科技龙头巡礼专题（三）	2025-02-21
行业普通报告	电子行业：DeepSeek 开源模型性价比突出，R1 模型性能对标 OpenAI o1 正式版—行业动态跟踪点评	2025-02-06
行业深度报告	行业深度：复盘历史上的英飞凌，如何走出行业低谷期？—海外硬科技龙头复盘研究系列（十二）	2025-02-06
公司普通报告	统联精密（688210.SH）：收入同比增长 10.01%，湖南/越南工厂逐步投产中—2025 年半年报业绩点评	2025-09-10
公司普通报告	统联精密（688210.SH）：收入增长 33.93%，积极布局 3D 打印等技术—2025 年一季报业绩点评	2025-05-09

资料来源：东兴证券研究所

分析师简介

刘航

电子行业首席分析师&科技组组长，复旦大学工学硕士，2022年6月加入东兴证券研究所。曾就职于Foundry厂、研究所和券商资管，分别担任工艺集成工程师、研究员和投资经理。证书编号：S1480522060001。

研究助理简介

李科融

电子行业研究助理，曼彻斯特大学金融硕士，2024年加入东兴证券研究所，主要覆盖半导体、面板等板块。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及报告作者在自身所知情的范围内，与本报告所评价或推荐的证券或投资标的的存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和法律责任。

行业评级体系

公司投资评级（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数）：
以报告日后的6个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率15%以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率5%~15%之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。

行业投资评级（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数）：
以报告日后的6个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。

东兴证券研究所

北京

西城区金融大街5号新盛大厦B座16层

邮编：100033

电话：010-66554070

传真：010-66554008

上海

虹口区杨树浦路248号瑞丰国际大厦23层

邮编：200082

电话：021-25102800

传真：021-25102881

深圳

福田区益田路6009号新世界中心46F

邮编：518038

电话：0755-83239601

传真：0755-23824526